



Integrated Annual Report 2024

統合報告書



先端技術を先端で支える

アドバンテストは最先端の「はかる技術」でイノベーションへの挑戦を続けます

当社の主力製品である半導体テストは、半導体がきちんと動作するか、
また求められている性能や耐久性を満たしているかを高精度・高効率にテストします。

当社は、半導体の品質や信頼性の確保を通じて世の中の
「安全・安心・心地よい」を支えています。

目次

02 目次

03 編集方針

04 アドバンテストの事業

Value Creation

- 06 Group CEOメッセージ
- 11 Group COOメッセージ
- 13 アドバンテストのあゆみ
- 15 Learn about Advantest
- 17 中長期経営方針「グランドデザイン」
- 19 第3期中期経営計画（MTP3）
- 21 コラム：進化する半導体～複雑化する半導体試験に効率性をもたらす"Automation of Test"～
- 23 CFOメッセージ
- 25 リスクマネジメント
- 27 サステナビリティの取り組み強化
- 29 サステナビリティ行動計画2024-2026

Planet (環境)

33 ESG行動計画2021-2023 E(環境)結果

34 GHG排出量削減

37 国際イニシアチブへの参画

38 生物多様性

People (社会)

- 40 ESG行動計画2021-2023 S(社会)結果
- 41 人権の尊重
- 42 サプライチェーン上の人権尊重
- 43 人財戦略・従業員エンゲージメント
- 44 イノベーション人財の育成
- 45 労働安全衛生
- 46 コミュニティ活動

Governance (ガバナンス)

48 コーポレートガバナンス

53 取締役一覧・スキルマトリックス

55 指名報酬委員インタビュー

Company Highlights

60 11年間の主要財務データ
61 連結財務ハイライト
62 連結非財務ハイライト

編集方針



アドバンテストの統合報告書は、財務上の実績に加えて、経営理念、ビジネスモデル、戦略、ガバナンスなど、当社の価値創造をご理解いただく上で重要な内容を、統合思考の観点から整理したものです。株主や投資家の皆さまをはじめ、幅広いステークホルダーの方にお役立ていただける内容を目指しています。

製作にあたっては、国際統合報告評議会（IIRC）の「国際統合フレームワーク」などのレポートングガイドラインを参考にしています。

なお、GRIスタンダードやSASB（米国サステナビリティ会計基準審議会）スタンダードなどへの対応については、当社ウェブサイト「ガイドライン参照表」をご参照ください。

<https://www.advantest.com/ja/about/sustainability/gri-standard/>

報告期間・範囲

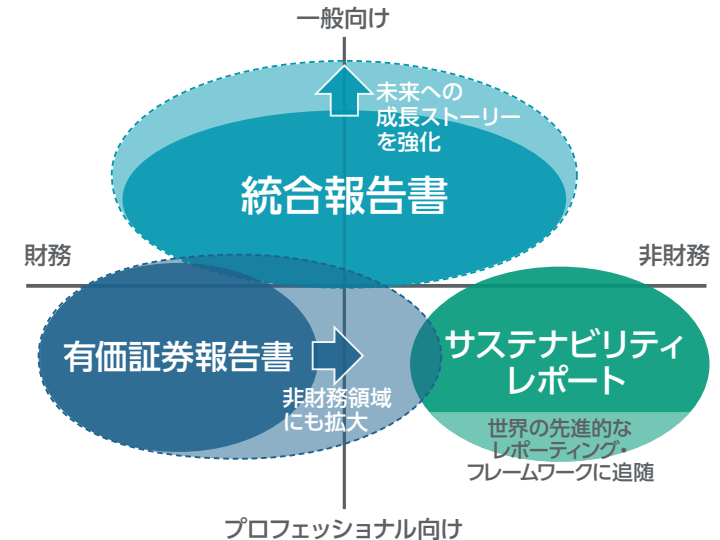
報告対象期間は2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）です。ただし、必要に応じて当期間の前後についても言及しています。データの集計範囲（バウンダリー）は、特に記載しているものを除いて、すべて連結決算対象範囲です。

将来の事象に係る記述に関する注意

本冊子には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積もりおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

情報開示体系

当社の企業価値創造への取り組みと成果については、主に「有価証券報告書」「サステナビリティレポート」「統合報告書」で開示しています。有価証券報告書は財務の、サステナビリティレポートは非財務のプロフェッショナルをメインの想定読者としているのに対し、統合報告書は財務と非財務の双方をカバーしつつ、一般読者にも分かりやすい内容を心掛けています。

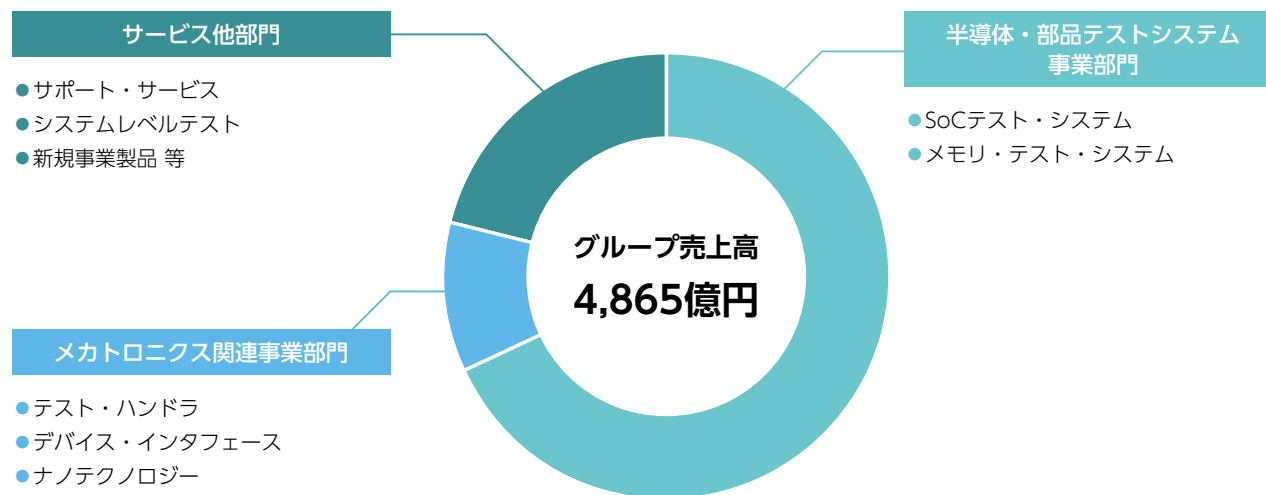


アドバンテストの事業

(2024年3月期)

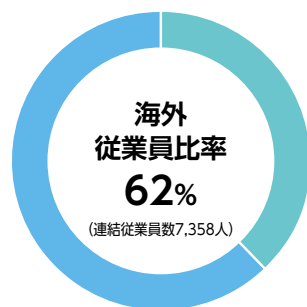
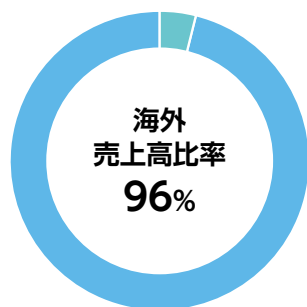
事業構成

当社の事業セグメントは、売上高の約7割を占める「半導体・部品テストシステム事業」、テスト・システムの周辺機器などからなる「メカトロニクス関連事業」、顧客サポートとシステムレベルテストを主とする「サービス他」の三つで構成されています。これらの製品・ソリューションの組み合わせにより多種多様な半導体、そして幅広い顧客ニーズへの対応を可能にすることが、当社の競争力の源泉となっています。

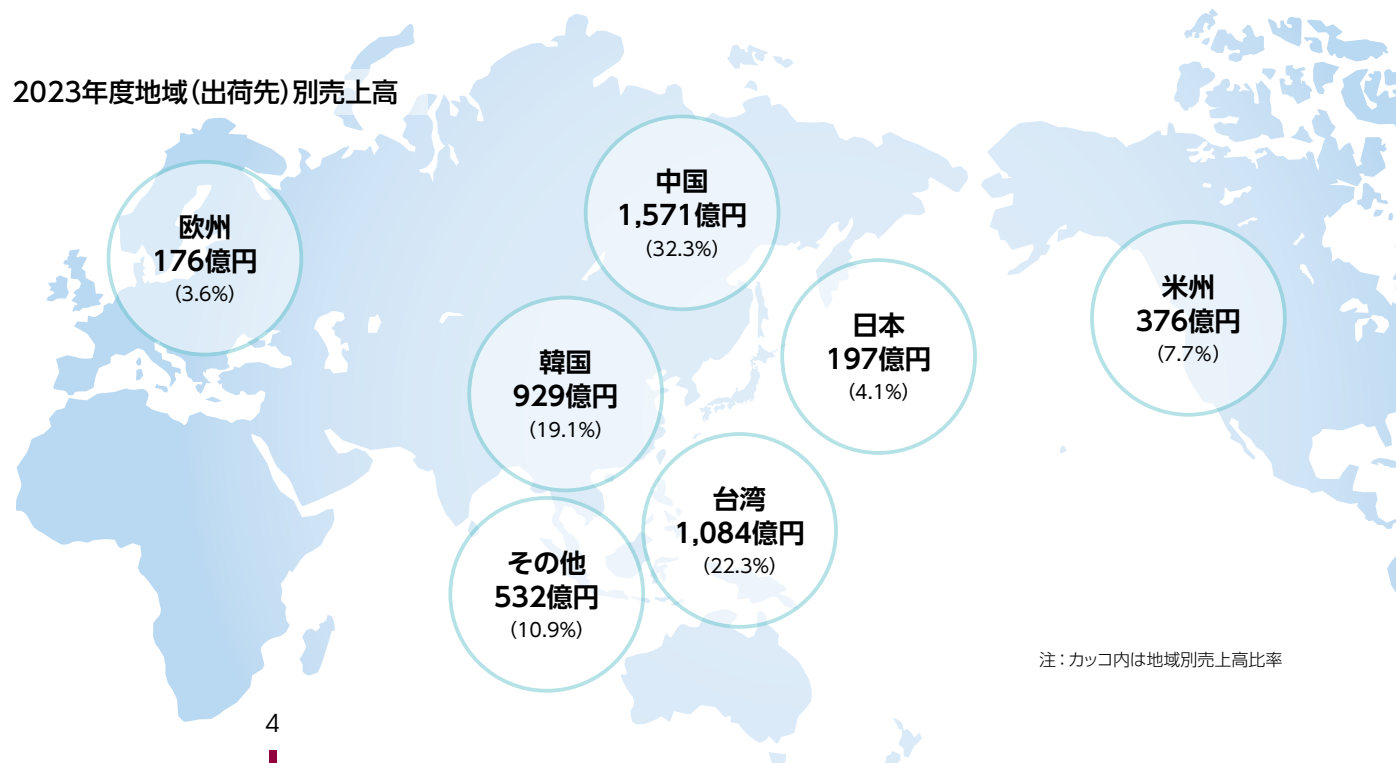


グローバルな事業展開

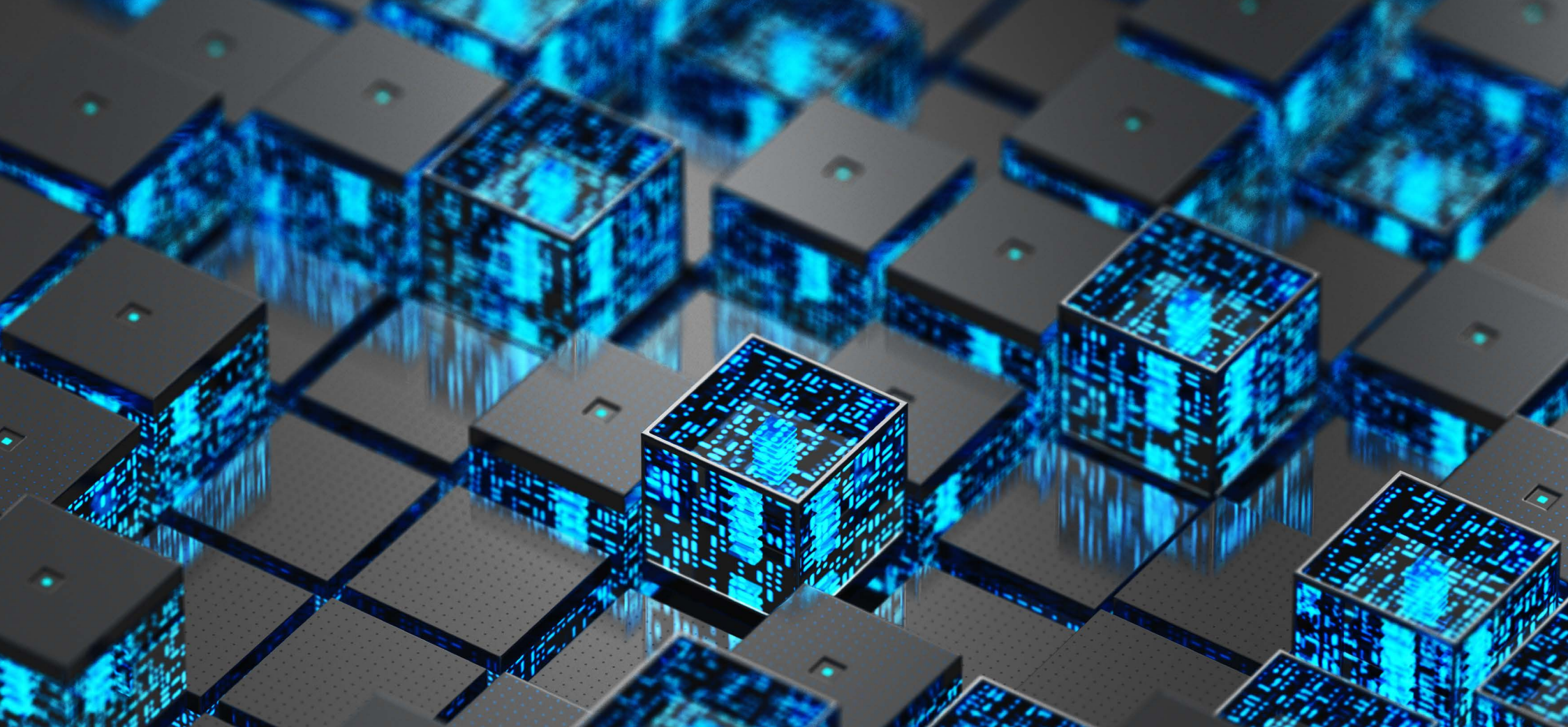
当社は多様な人材とグローバルなネットワークを活かし、世界中のお客さまの課題解決に取り組んでいます。



2023年度地域(出荷先)別売上高



注：カッコ内は地域別売上高比率



Value Creation

- | | | | |
|----|-----------------------|----|--|
| 06 | Group CEOメッセージ | 21 | コラム：進化する半導体
～複雑化する半導体試験に効率性をもたらす"Automation of Test"～ |
| 11 | Group COOメッセージ | 23 | CFOメッセージ |
| 13 | アドバンテストのあゆみ | 25 | リスクマネジメント |
| 15 | Learn about Advantest | 27 | サステナビリティの取り組み強化 |
| 17 | 中長期経営方針「グランドデザイン」 | 29 | サステナビリティ行動計画2024-2026 |
| 19 | 第3期中期経営計画（MTP3） | | |

Group CEOメッセージ



ダグラス ラフィーバ

代表取締役兼経営執行役員
Group CEO

複雑性の時代における「信頼」と「イノベーション」による価値創造

半導体業界が複雑さを増す中で、バリューチェーン全体における信頼関係の強化と、装置サプライヤーのイノベーションがこれまで以上に必要とされています。当社は、こうした要求に応えるために優位なポジションを築いています。

新たな出発

私は1998年にアドバンテストに入社して以来、さまざまな役職経験を通じて、非常に優秀な方々から多くのことを学ばせていただきました。Group CEOとして新たな職責を担うにあたり、この25年間で培った知識や経験を共有できることを光栄に思います。私にとってアドバンテストは単なる会社ではありません。むしろ、私という人間の大きな部分を占めており、私の人生の

根幹と言えるでしょう。この会社に対する私の強いコミットメントと情熱を、すべてのステークホルダーの皆さまと分かち合えることを大変嬉しく思います。

私は、幸運にもこれまでアドバンテストを率いてきた歴代のリーダーとともに働く機会に恵まれました。彼らが築き上げたレガシー、すなわち、世界中のお客さま、パートナー、地域社会からの信頼と尊敬を守ること全力を尽くすとともに、アドバンテストがグローバル企業へと進化していく中で、当社のルーツとコア・バリューを継承していくことをお約束します。

“信頼とイノベーションは当社の成功の基本です。
グローバル・チームと緊密に協力し、これらの柱をもとに
前進してまいります。”

Group CEOメッセージ

当社の未来に目を向けると、「信頼」と「イノベーション」という二つの言葉が強く響き合うはずです。私たちは長年にわたり、お客さまやステークホルダーの皆さまとの深い信頼関係を培ってきました。卓越したソリューションでお客さまから信頼を得るため、また、比類ない品質と経済的価値を備えた優れた製品を提供するために、当社は自己研鑽し続けなければなりません。また、複雑化する半導体デバイスに対応するためには、研究開発への投資が不可欠です。信頼とイノベーションは当社の成功の基本です。私はグローバル・チームと緊密に協力し、これらの柱をもとに前進してまいります。

過去の中期経営計画を振り返って

過去二つの中期経営計画（MTP1、MTP2）において、当社は三つの大きな成果を成し遂げました。

一つ目の成果は、半導体テスト開発への投資により、業界随一の製品ポートフォリオを構築したことです。当社の半導体テストで測定できない半導体はない、といっても過言ではありません。

ません。過去6年にわたるMTP1、MTP2において行ったコア事業への投資は、今後の当社の成長の基盤となるものです。

二つ目の成果は、主に近縁市場領域における、戦略的かつ相互補完的な投資です。既存市場における事業強化に加え、システムレベルテスト、テスト・インタフェースおよびソケット、そしてデータ・インフラストラクチャ領域においてビジネスを拡大しました。

三つ目は、半導体産業が盛んな主要地域に戦略的に当社拠点を設けたことです。開発、R&D、営業、サポートの各分野で存在感を高め、人材を強化することで、お客さまとの強固な関係を構築することができ、それが業界内における現在の当社のポジショニング優位性につながっています。

MTP1およびMTP2では、事業ポートフォリオ、製品提供、およびグローバル展開の拡大に重点を置いていました。このような取り組みを通してお客さまからの信頼をより一層獲得したことで、2017年から2023年にかけて市場シェアは36%から58%に、売上高は2.4倍に、時価総額は10倍にまで伸長し、大きな成長を遂げることができました。

MTP3のゴール

2024年6月、当社は新たなビジョン・ステートメント「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーへ」を掲げ、ブランドデザインのアップデートと第3期中期経営計画（MTP3）を発表しました。

私たちの世界は大きな変化の中にあります。技術の飛躍的進歩は、持続可能な世界を実現しようとする取り組みと相まって、イノベーションと高性能半導体への需要を促進しています。さらに、地政学的リスクの高まりは、半導体製造能力の増強と地理的な再配分につながっています。

高度な製造技術が求められる高性能半導体の需要増加と、バリューチェーンの多様化は、半導体産業に「複雑性の時代」をもたらしています。複雑さを極める半導体デバイスの開発において、最先端のテスト装置を提供するアドバンテストの役割はますます重要性を増しており、それは当社にとってさらなる成長のチャンスであると捉えています。そしてこの新たなグローバル・ビジネス環境のニーズに対処するためには、「効率

“高度な製造技術が求められる高性能半導体の需要増加と、バリューチェーンの多様化は、半導体産業に「複雑性の時代」をもたらしています。複雑さを極める半導体デバイスの開発において、最先端のテスト装置を提供するアドバンテストの役割はますます重要性を増しており、それは当社にとってさらなる成長のチャンスであると捉えています。”

Group CEOメッセージ

性」が鍵になると考えています。自動化されたテスト・ソリューションでテストプロセスの改善とお客さまの課題解決に貢献することで、これまでにない効率性を実現し、最先端のデバイスを世の中に生み出していくお客さまを全力でサポートしてまいります。

さらなるトレンドと機会

2023年に出現した市場傾向の多くが2024年も続く予想され、それらは特にAIの継続的な進化に関連しています。大規模言語モデル（LLM）やその他の機械学習（ML）アプリケーションは、一つのモデルを動かすために数十万ものGPU/CPUプロセッサが並列動作するデータセンターを必要とします。一つのプロセッサが故障すると、モデル全体を再起動しなければならず、顧客にとって大きな負担となります。そのため、AI技術の発展には品質と信頼性が不可欠であり、不良品ゼロDPPM*を求める顧客が増えるにつれて、テストの必要性が非常に高まっています。

HBM（High Bandwidth Memory）は、データセンターでGPUと並んでAIアプリケーションに広く使用されています。HBMは、複数のDRAMモジュールを3D積層したものです。この技術は、低消費電力と小さなフットプリントを維持しながら、より高速なデータ処理を実現し、近年急速に普及しています。しかし、2.5D/3Dなどの先端パッケージは複雑で高密度であるため、信頼性を確保するために実使用時と同様な温度テストやシステムレベルテストが必要になることが多く、さまざまなテスト独自の課題が生じます。このような2.5D/3D積層デバイスは製造コストが高いため、歩留まりを向上させるために製造プロセス全体を通して、より多くのテストを行う必要性が高まっています。アドバンテストのエンジニアは、長年にわたりHBMの課

“私たちは、地球を含むすべてのステークホルダーのニーズに応える持続可能な企業になることを目指しています。”

題に取り組んできた実績があり、幅広いテスト・ソリューションを提供することで、このような新しい技術に伴う課題を克服することができます。

また、この先、エッジ・アプリケーションの出現により、業界の急成長に拍車がかかると見込んでいます。生成AIがスマートフォンやPCを通じて消費者の手に届くようになると、私たちの日常生活にAIが深く組み込まれるようになり、ハイエンド半導体の需要がさらに高まると予想されます。この市場を獲得するためには、準備が重要だと考えています。つまり、将来のエッジ・デバイスの需要に対応するためには、生産能力の拡大、研究開発への投資、近縁市場での新たなビジネス機会の創出が不可欠となるのです。

*Defective parts per million: DPPM、100万分の1単位の欠陥発生率

持続可能な社会に向かって

持続的な成長は当社の企業戦略の基盤となるものです。コンピュータ、スマートフォン、自動車など、半導体は私たちの日常生活において大きな役割を果たしており、その影響はAIアプリケーションの発展によってさらに深まることが予想されます。私たちは業界のリーダーとして、この技術の責任ある発展を促

進し、持続可能な未来の実現に向けて対策を講じる必要があります。

当社は、ESG行動計画2021-2023で掲げた有害物質の排除や再生可能エネルギーの導入拡大といった多くの目標を達成し、サステナビリティの推進に積極的に取り組んでいます。また、当社は半導体気候関連コンソーシアム（SCC）の創設メンバーとして参画し、半導体バリューチェーン全体のGHG排出量削減を加速するため、業界のパートナーとともに積極的に活動を続けています。

MTP3と同期して策定した新たなサステナビリティ行動計画2024-2026では、取り組むべきテーマをステークホルダーへの提供価値拡大という観点に基づくものへ全面的に再編するとともに、それら各テーマに対する中期目標を新たに設定しました。さらに計画名称についても今後の取り組み内容と範囲により即したものに変更しました。このように、サステナビリティの取り組みに関するガイドラインを明確化し、社員を適切に巻き込むことで、それぞれのビジネス・ユニットが具体的な共通目標に向かってサステナビリティへの取り組みをワールドワイドで推進してまいります。

Group CEOメッセージ

独自の企業文化を築き上げた70年

当社は、2024年7月1日に創立70周年を迎えました。アドバンテストは、1954年、わずか3名の従業員からスタートした計測器メーカーです。それから70年、長年の努力と技術革新により、半導体試験装置のグローバル・リーダーへと成長しました。アドバンテストは、数十年にわたる成功の積み重ねにより、

グローバル企業へと変貌を遂げ、国際社会の多様なニーズに応えています。私たちのルーツである日本には、誠実さ、協調性、チームワーク、そして品質への揺るぎないコミットメントを重んじる優れた文化的基盤があります。アドバンテストは、「日本生まれのグローバル・カンパニー」として、社会の向上に資する先進的な半導体の開発をサポートし、最先端技術を支えるという当社の使命に誇りをもち、挑み続けています。

こういった当社のすべての行動の礎となっているのが、

「INTEGRITY」です。多様な価値観を受け入れ、永続的な成長と成功を目指す独自の企業文化を発展させることを通して、地球を含むすべてのステークホルダーのニーズに応える持続可能な企業になることを目指しています。

私たちは、自信と決意を胸に、ともに未来に立ち向かってまいります。

“アドバンテストは、「日本生まれのグローバル・カンパニー」として、社会の向上に資する先進的な半導体の開発をサポートし、最先端技術を支えるという当社の使命に誇りをもち、挑み続けています。”

Douglas Lefever
Group CEO

Group CEOメッセージ



Group COOメッセージ



Koichi Tsukagawa

津久井 幸一

代表取締役兼経営執行役員社長
Group COO

企業文化「INTEGRITY」が育む、 日本生まれのグローバル・カンパニー

当社は、社員一人ひとりが「INTEGRITY」(誠実・真摯・高潔の意)を実践することで、日本的な強みとグローバルなチームワークを活かし、半導体業界の課題解決に貢献することを目指しています。

2024年4月、経営執行役員社長 Group COOに就任しました。長年ともに理解し合い、ケミストリーを醸成してきた Douglas Lefever Group CEOとともに、さらなるグローバル経営体制の進化に挑戦できることを、とても楽しみにしています。

半導体市場は、AI関連技術での需要を支えに今後も成長を続け、2030年代に市場規模は1兆ドルに達すると予想されています。

また、半導体産業を取り巻く「複雑性」の増大は産業界の課題である一方で、当社にとって大きなチャンスになりえます。私たち経営チームの使命は、この複雑性の変化を捉え、新たな成長を加速させていくことだと認識しています。

アドバンテストは日本で生まれた会社ですが、海外売上高比率が96%、外国籍の社員が60%を超えるグローバル企業です。

I

INNOVATION

私たちが起こすもの

- ・私たちは、現状に満足せず常に挑戦し続けます。
- ・私たちは、技術の利活用と起業家精神をもって、新たな顧客価値創出に努めます。

N

NUMBER ONE

私たちが目指すポジション

- ・私たちは、我々の事業領域において、常にリーダーを目指します。
- ・私たちは、業界のトップランナーとして、卓越したスタンダードを確立し続けます。

T

TRUST

私たちを一つにする礎

- ・私たちは、すべてのステークホルダーとともに信頼し合えるパートナーです。
- ・私たちは、互いの能力、想いを認め合います。

E

EMPOWERMENT

私たちの成長の機会

- ・私たちは、主体性を持って仕事に取り組みます。
- ・アドバンテストの成功は私たち一人ひとりにかかっています。

Group COOメッセージ

勤勉性や協調性、品質へのこだわりといった日本的な強みをベースにしつつ、世界のイノベーションをリードするIT・ハイテク企業へのアクセスやパートナーシップ力、そしてグローバルなサポート力を併せ持った稀有な企業だと言えます。当社の経営理念（パーパス&ミッション）は「先端技術を先端で支える」ですが、これからもこの優位なポジションを活かし、世界の最先端の半導体技術の課題や困りごとに真っ先に取り組み、解決していくことで、社会の発展に貢献していきたいと考えています。

一方で、どんなに科学技術が発達しようとも、「企業は人」であることは不変です。企業の戦略を実現し、事業を牽引するのは社員だからです。さまざまな知識や能力を持った人と人同士が互いに信頼し、協働し、決断できる状態をつくることが何より重要です。

そのためにも当社ではコア・バリュー「INTEGRITY」（誠実・真摯・高潔）を掲げ、社員には日々の業務での実践を求めています。INTEGRITYな資質を備えた人財の育成こそが、

長期的な当社のサステナブルな成長に繋がると考えており、これからも人財への投資に注力していきます。

アドバンテストの一番の強みは、グローバルなチームワーク力だと私は考えています。複雑に入り組んだ諸課題への取り組みには、国や部門を横断した緊密なコミュニケーションが必須となります。INTEGRITYの企業文化のもと世界中のアドバンテスト社員7,300名が心をつなげて、チームの力を最大化することができれば、きっとどんな難題でもクリアできるはずです。

また、グローバルなチームワーク力は、当社の経営チームにも当てはまることです。変化の激しい半導体産業の中で、当社は独自の経営体制を築き上げてきました。これからもGroup CEOのDougがリーダーシップを発揮し、グローバルな経営に専念できるよう、私はGroup COOそして社長として彼を支え、当社の経営チーム力を最大化することを目指していきます。

G

GLOBAL

私たちが活躍するフィールド

- ・私たちは、絶え間なく変化する世の中に適応し続けます。
- ・私たちは、常に素早く動きます。いつでも、どこでも。

R

RESPECT

私たちの信条

- ・私たちは、さまざまな文化や慣習を尊重します。
- ・私たちは、企業倫理に反する行為は絶対に行いません。

I

INCLUSION AND DIVERSITY

私たちの誓い

- ・私たちは、アドバンテストの多様な人材と能力を誇りに思います。
- ・私たちは、多様性を取り入れることで強くなると信じます。

T

TEAMWORK

私たちの仕事の進め方

- ・私たちは、国や組織を越えたチームワークで、能力を最大限発揮します。
- ・私たちは、お互いに心を開いて切磋琢磨し、お互いの成果をたたえ合います。

Y

YES

私たちの姿勢

- ・私たちは、成果を残したいと思います。成果は、まずは始めてみるからです。
- ・私たちは、「できない」は一つの考え方にとどまらず、想像力を通じて世の中を変えることが「できる」と信じます。

アドバンテストのあゆみ

創業期: 1950s, 1960s

日本のエレクトロニクス産業の技術課題をとらえ、事業の足場を築く

アドバンテストは「タケダ理研工業株式会社」という社名で1954年に創業しました。創業者の武田郁夫は、大企業との競争に打ち勝つには新しい技術を柱に据えるべきと考え、直流電子技術とパルス技術を軸にした測定機分野に狙いを定めました。これらの技術は、その後当社が半導体テスト・システム事業に参入する際の基礎にもなっています。

同年、最初の自社製品として微小電流計「マイクロ・マイクロ・アンメータ」を発売しました。小型で振動に強いなど、従来製品の問題点を解決した当製品は順調に売り上げを伸ばし、当社のスタートアップに大いに貢献しました。そこで得られた、顧客の潜在的な要求を見極め新たな技術でその要求に応える、狙った市場でナンバーワンを獲得するといった経験は、その後の当社の経営方針および戦略にも色濃く反映されています。

1960年代、日本経済は高度成長期に入り、日本のエレクトロニクス産業も大きく伸びていきました。当社は、当時世界最高性能の100MHzエレクトロニクス・カウンタ(1962年)や、日本初のデジタル電圧計(1963年)など、先進的な電子計測器を世に送り出し、エレクトロニクス産業の技術開発を下支えしました。



創業時の写真。東京都板橋区の一隅にあった数坪の事務所兼作業場から当社の歴史はスタートしました。前列左から2人目が創業者 武田郁夫

最初の飛躍: 1970s~1990s

半導体産業の成長を予見しテスト事業に進出、世界市場シェアナンバーワンに

当社は、半導体産業が今後大きく発展すると予測し、1968年に半導体テスト・システムの開発に着手しました。巨額の開発費を投じたものの、1973年に石油ショックが到来し業績は低迷、一時は経営の先行きも危ぶまれました。しかし、半導体の集積化が進み大型コンピューターなどに搭載されるとともにテスト・システムの需要が急増し、当社の業績も1976年に好転。テスト・システム事業の売上高が計測事業の売上高を上回り、その後当社は半導体テスト市場でのポジションを築いていきます。

1979年、世界初の試験速度100MHzを実現したテスト・システムを発表し、業界内で評判を博しました。翌1980年には

その技術をブレイクダウンし、市場ニーズの高いミッドレンジのシステムを短期間でリリースしたほか、1982年以降米国、欧州、アジア各地と世界市場に進出しました。1985年にはテスト・システム市場の世界シェア第1位を初めて獲得した後、1987年から1991年まで5年連続第1位に輝きました。

パソコンが半導体需要のけん引役となった1990年代、高速データ転送が可能なシンクロナスDRAMの時代を予見した当社は、1995年にそのテストが可能なメモリ・テスト・システムを他社に先駆けてリリースし、これが記録的ヒット商品となりました。



米国大手企業に納品された当社テスト・システム。1980年代初頭、当社は後発メーカーでしたが、米国市場で性能や信頼性を評価いただき、ビジネスを獲得することができました。

ビジネスの転換期:2000s, 2010s

半導体ビジネスの国際的分業化に対応し第二の成長期へ

半導体ビジネスのドライバーがパソコンからモバイル機器にシフトした2000年代、半導体バリューチェーンに設計と製造の国際的な分業化という新たなトレンドが到来しました。その影響は半導体テスト市場でとりわけ大きく、テスト・メーカーには半導体設計企業と製造企業それぞれの要望を、国境や時差を跨いで調整するグローバルなビジネス・オペレーション能力が求められるようになりました。2000年のインターネットバブルの崩壊や、2008年の世界金融危機といった大きな景気後退も加わり、半導体テスト市場は買収や撤退など企業の再編が進みました。

当社は、半導体ビジネスの日本から海外へのシフトには対応したものの、国際的分業化への対応はスムーズに進みませんでした。テスト・システムのアーキテクチャーのオープン化などさまざまな施策を経た後、2011年に業界第3位のVerigy社の買収に踏み切りました。同社が得意としたグローバルなオペレーションと、当社の広範な開発および顧客サポートリソースを融合し、買収後数年間は将来の成長が見込める市場の開拓や顧客とのパートナーシップ強化に努めました。

2018年、当社初のグランドデザイン（中長期経営方針）および第1期中期経営計画（2018年度～2020年度）を発表しました。計画では、データの重要性が増す社会において半導体に品質と信頼性のさらなる向上が求められるようになり、テストビジネスが半導体ビジネス以上の成長が可能になるという想定のもと、10年後の売上高を4,000億円に倍増させるという、当時としては野心的な目標を立てました。その後半導体テスト市

場は急拡大。それまでのテスト・ソリューションや顧客ベースの強化策が実を結び、当社は新たな成長ステージに入りました。



Verigy社買収記者会見。交渉の大詰めで東日本大震災に見舞われたものの、震災発生から19日後に交渉をまとめあげ会見を行うことができました。右が松野晴夫社長（当時）

100年企業を目指して:2020s and beyond

価値あるテスト・ソリューションで半導体の進化に貢献

当初のグランドデザインで10年後と想定していた売上高4,000億円を、2021年度にクリア、第2期中期経営計画の3年間平均（2021年度～2023年度）で4,879億円を記録しました。テスト市場における当社シェアは36%（2017年）から58%（2023年）、時価総額は4,000億円（2018年3月）から4兆円（2024年5月）と大幅に増加しました。

半導体ビジネスは、技術とサプライチェーンの両面で複雑化が進み、より高度なテスト・ソリューションが求められています。

当社の第3期中期経営計画（2024年度～2026年度）では、ビジョン・ステートメントを「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーへ」と再定義するとともに、3年間の平均売上高目標を5,600～7,000億円に設定しました。

データ中心の社会を支える半導体は、ますます高機能化・複雑化・大容量化し、これまで以上に高い信頼性が求められるようになっています。半導体がデジタル革命を推し進めるとともに、半導体バリューチェーンが一層進化・拡大する中、当社はシステムレベルテストやデータ・アナリティクス分野への事業拡大など、新しい顧客価値創造を通じて100年企業を目指します。



当社システムレベルテスト・システムの設計・販売を担う Advantest Test Solutions, Inc. (米国カリフォルニア州)

Learn about Advantest

What we do : アドバンテストのビジネスフィールド

アドバンテストは、電子計測技術を活用して、産業界のさまざまな課題を解決する会社です。創業当初は、電圧電流計や周波数カウンタを開発・製造し、その後半導体テスト事業にビジネスの軸足を移し、半導体バリューチェーンのグローバル化に追随し海外でのビジネスを伸ばしてきました。2023年度の総売上高のうち、半導体・部品テストシステム事業の売上高は68.1%、海外売上高は96.0%を占めています。

現在の主力製品である半導体テスト・システムは、半導体プロセスの進化に大きな役割を果たしています。テストは単に良品と不良品を判別するだけでなく、得られたデータから設計や製造プロセスに関わるさまざまな情報を読み取ることができます。データは前の工程にフィードバックされ、歩留まりの向上、製造プロセスの微調整、設計の改善など多方面に活用されます。とりわけ最先端の半導体は、いち早く市場に投入できれば大きな商機につながる一方で、確立途上の最新技術を用いるが故に品質や信頼性に課題があることが少なくありません。顧客は課題の原因を突き止めるために、量産工程はもちろんのこと、設計や製造プロセス評価の段階からテスト・システムを積極的に活用します。顧客にとってテスト・システムは、先端半導体の技術課題解決と迅速な市場デリバリーを可能にするという大きな価値をもたらします。

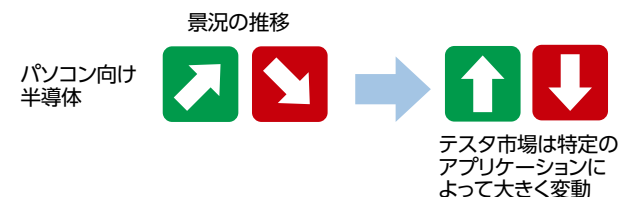
テスト・システムは半導体の品質や信頼性向上に役立てられていることの裏返しとして、製造プロセスの改善が進み歩留まりが向上すると、そのプロセスに必要なテスト・システムの台

数は少なくなります。かつての半導体テスト市場は、パソコンやモバイル端末の半導体需要に大きく依存し、その半導体の世代サイクルに連動して大きなアップダウンを繰り返してきました。しかし近年は、データトラフィック増加やAIの普及を背景としたデータサーバーの拡張、自動車の電動化・スマート化など、半導体需要のドライバーが広がりを見せています。また、半導体の技術的複雑化や信頼性要求の高まりが、テストのボリュームの増加や、システムレベルテストといった新たなテスト・アプローチの必要性にもつながっています。こうした背景により、半導体テスト市場はかつてよりは小さな変動サイクルを含みつつも安定的に成長する、市場へと変貌しています。

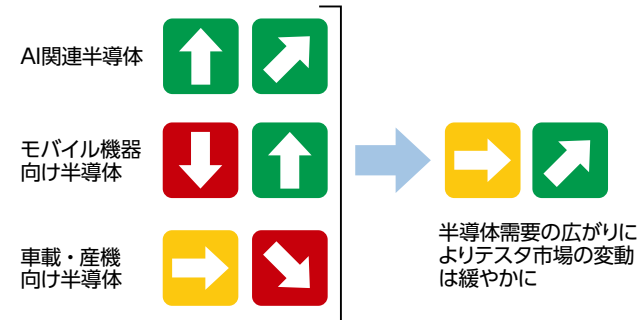
Why Advantest : 強固なビジネスモデルの源泉は「技術力」と「グローバル・オペレーション」

当社のビジネスモデルの核心は、先端の計測技術で顧客の課題解決に貢献することです。業界の先端に行く顧客の声に耳を傾け、顧客の課題の根源にあるもの、内包される本質を追究し、的確なソリューションとサポートをアウトプットする。そしてアウトカムとして顧客の課題解決に貢献し、顧客との絆をより強くし、そして次の課題解決に取り組む。創業時の計測器ビジネスから、現在の半導体テストビジネスに至るまで、このサイクルを70年回し続けています。

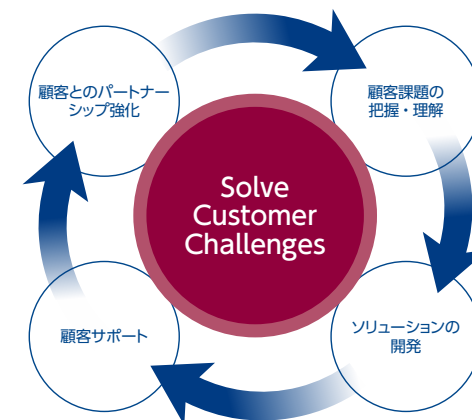
過去のテスト市場のイメージ



現在のテスト市場のイメージ



顧客との関係強化の好循環



Learn about Advantest

しかしそれだけでは、高度化する顧客の課題に応えることや、競合企業との競争に打ち勝つには不十分です。当社が他社の追従を許さない真の強みは、チームワークを基礎とする「技術力」と「グローバル・オペレーション」にあります。

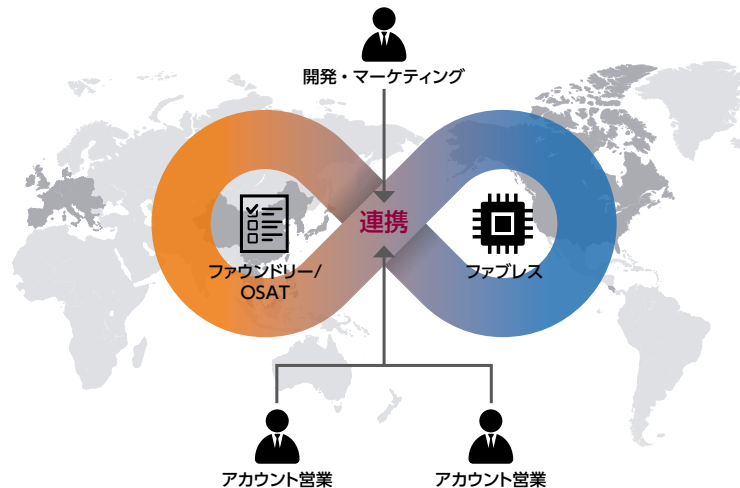
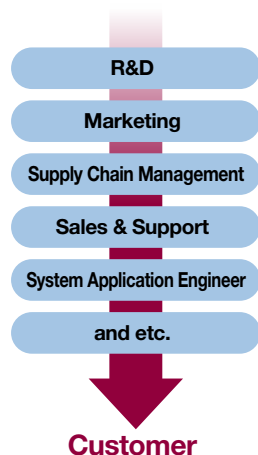
当社の技術力は、個々の社員の能力はもちろんのこと、各部門の優秀な社員によって構成されるプロジェクトチームが大きな役割を果たしています。当社のソリューション開発は、5年先にどのような課題が生じ、その解決にどのような技術が必要になるかを予測するところから始まります。AI半導体が急速に普及したように、半導体市場は非常に変化の激しい市場です。加えてテスト・システムが通常10年から15年にわたって使用されることを想定すると、必要な技術の予測は容易ではありません。また、半導体の進化とともに、パッケージング、チップレット、光学、熱処理、ソフトウェアなど技術的複雑さも指数関数的に増大し、そこで生じた課題の解決には分野を横断したアプローチが必要です。当社の開発プロジェクトは、マーケ

ティング、研究開発、サポート、サプライチェーン・マネジメントなどさまざまな部門から多様な知見や経験を持つプロフェッショナルたちが集い、イノベーション、情報、技術を共有し、ソリューションの最適解を総合的に判断します。相互依存的に複雑化した課題をスピーディーに解決する上で、ウォーターフォール式組織によるアプローチでは限界があります。各組織の専門知識を統合しつつトレードオフの最適解を追究できるクロスファンクショナル・チームの優位性は、半導体テスト市場における当社の高いシェアが裏打ちしています。

一方のグローバル・オペレーションについても、部門や地域を横断したチームワークが欠かせません。当社のテスト・システムの多くは、ファウンドリーやOSATと呼ばれる半導体の製造やテストを受託する企業に設置され、このような企業には自らが保有するテスト・システムの稼働率を向上させたいというインセンティブが存在します。しかしテストはその上流工程の設計評価段階から始まっています。ファブレスと呼ばれる設計専

業企業が使用したものと同一機種のテストを量産用途でも採用することで、設計時のテスト・プログラムやデータを活用し新製品の量産をいち早く立ち上げることが可能になります。テストビジネスはファウンドリーやOSATと話を進めるだけでなく、ファブレスの意向を調整し商談をまとめあげる必要があります。また、半導体サプライチェーンはグローバルに広がり、ファブレスは北米でファウンドリー／OSATはアジアといったような、各社が地理的に離れているケースが往々にしてあります。当社ではアカウント営業、マーケティング、システム・エンジニアやフィールド・サービス、さらには開発も加わり、地域横断でチームを組み顧客に相対します。顧客のニーズ、半導体市場やテスト技術の動向、当社のソリューション・ポートフォリオなどを統合し、ファブレスとファウンドリー／OSAT双方の要求をできるだけ満足するソリューションを提案します。このグローバル、シームレスかつきめ細かなサポートが、顧客とのパートナーシップの強化につながります。

卓越した技術力やグローバル・オペレーションを可能にする、ファンクションや地域を横断したチームワークは、単に人々が集まれば機能するわけではありません。チームメンバーが結束し同じ目標に向かうために、当社ではコア・バリュー「INTEGRITY」を社員全員で共有しています。INTEGRITYは「INNOVATION」「NUMBER ONE」「TRUST」「EMPOWERMENT」「GLOBAL」「RESPECT」「INCLUSION AND DIVERSITY」「TEAMWORK」「YES」の頭文字をまとめたものです。2019年の制定以来、研修、ワークショップ、全社表彰、モデルケースの紹介、さらにはオリジナルマスコットの公募と選定などさまざまな活動を通じて、INTEGRITYを企業文化のレベルにまで高めることに取り組んでいます。



中長期経営方針「グランドデザイン」

当社の経営理念は「先端技術を先端で支える」です。この経営理念を体現する会社であり続けるため、当社がどうありたいか、何をなすべきかを定めた中長期経営方針「グランドデザイン」を2018年度に策定し、企業価値の向上に取り組んでいます。

2024年6月、最新の長期事業環境見通しを踏まえて「グランドデザイン」を更新しました。ビジョン・ステートメントを改めたほか、ステークホルダーへの提供価値拡大を長期的な経営目標として決めました。また、2024年度から2026年度までの中期経営計画(MTP3)を制定しました。

(1) 当社の中長期経営方針の構成

① 経営理念

1990年以来常に掲げ続けている、私たちの存在意義です。私たちは世界中の顧客にご満足いただける製品・サービスを提供するため、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通して社会の発展に貢献していきます。

② グランドデザイン

経営理念を体現する会社であり続けるため、長期的にどうありたいか、そしてそのために何をなすべきかを定めた中長期経営方針です。全世界の従業員が一丸となって顧客価値創造と企業価値向上に取り組むための共通の経営目標として、2018年に初めて策定しました。

③ ビジョン・ステートメント

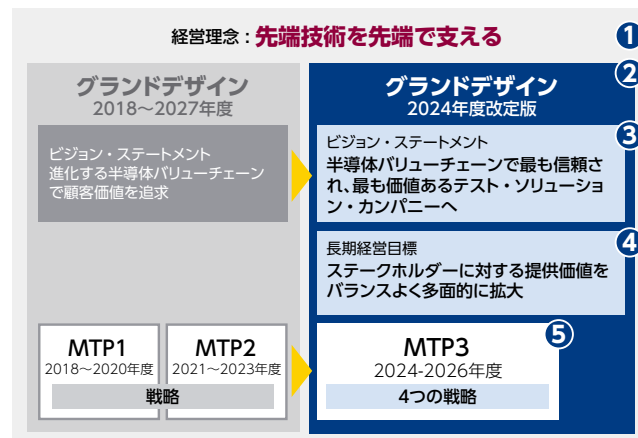
当社グループが将来どのような姿になりたいかを示すものです。最新の長期事業環境見通しを下敷きとしつつ、どうすれば当社グループが顧客や社会にとって価値ある存在であり続けるかを改めて見直し、2024年6月に更新しました。

④ 長期経営目標

2024年のグランドデザインの改定時に新たに設定したものです。

⑤ 中期経営計画

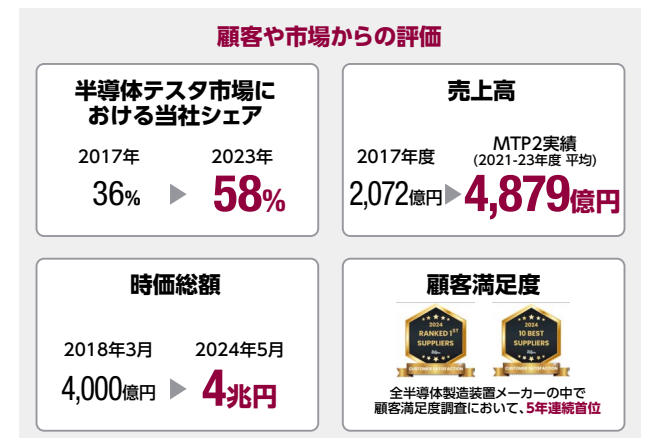
グランドデザインで描いたありたい姿の実現に向けた取り組みと数値目標を具体的に定めた3年間の経営計画です。これまでに二つの中期経営計画を遂行し、2024年度からの新たな3年間に向けた「MTP3」を2024年6月に制定しました。



(2) グランドデザインのこれまでの取り組みによる3つの成果

- (1) 半導体テスト開発への投資により、業界随一の製品ポートフォリオを構築
- (2) 近縁市場領域における、戦略的かつ相互補完的な投資
- (3) グローバルサポート力増強

これらの成果は、市場シェア・売上・時価総額の拡大として現れたほか、お客さまからの当社ソリューションへの高い評価につながっています。



中長期経営方針「グランドデザイン」

(3)グランドデザインの見直し

2018年の「グランドデザイン」策定時には、デジタル革命の進展、半導体が使われるアプリケーションの拡大という需要変化により、半導体テスト市場は安定的に成長軌道を歩む市場に変化したことから、海外企業に対するM&Aの実施による製品ポートフォリオの拡大とグローバルな事業基盤の拡張を行いました。

一方で将来に目を転じてみると、半導体市場および半導体テスト市場は2018年の「グランドデザイン」策定時に予想した方向に概ね沿って推移しているものの、現下の生成AIの急速な普及に代表されるように、半導体やエレクトロニクス関連産業は

ダイナミックに進化し続けています。また、当社グループが対応すべきサステナビリティ関連の課題も、過去に想定したよりも急ピッチで対応の強化・深化が求められていくと思われます。

こうした状況を総合し、当社グループが今後さらに発展を遂げるためには、より長期の視点に基づく経営方針が必要な状況にあると判断しました。そこで当社グループは、「グランドデザイン」の時間軸を延長するとともに、その内容をこれまでの経営・事業体制の変化や最新の長期事業環境見通しを踏まえたものへ2024年6月に更新しました。

最新の長期事業環境見通しを下敷きとしつつ、どうすれば当社グループが顧客や社会にとって価値ある存在であり続けるか

を、改めて見直しました。その結果として次の2点の変更を行うこととしました。

①ビジョン・ステートメントを下記の内容に更新しました。

「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーへ」

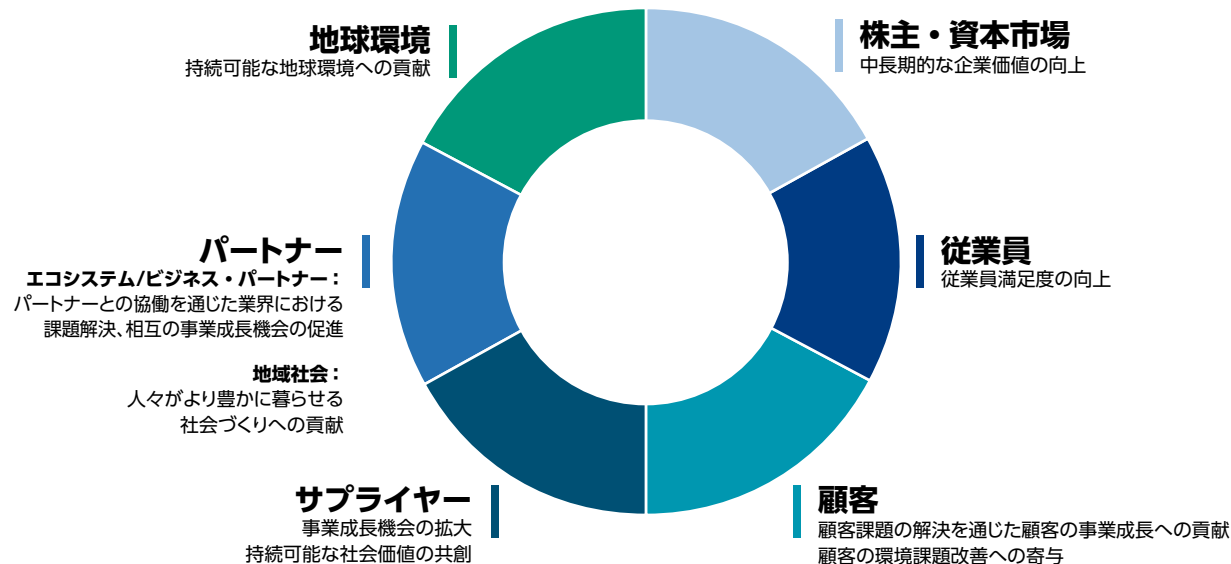
当社グループは、提供価値の拡大を通じ、すべてのステークホルダーから半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーとなることを目指します。半導体テストというハードウェア製品をお客さまに販売するのみではなく、より複雑化する半導体試験に効率よくアプローチできる半導体テスト・ソリューションという新たな価値を提供し、半導体バリューチェーン全体にとって不可欠な企業となることを目指します。

②当社グループが主要なステークホルダーに対して提供すべき経済的・社会的価値を改めて定義し、それら提供価値の拡大を当社グループの経営における長期的な目標とすることを決定しました。

当社グループは、顧客課題の解決を軸としながら、サステナブルな社会実現につながる各種取り組みを今後一体的に推進します。そして同時に、当社グループを取り巻く各ステークホルダーの期待や要請を事業活動に適切に反映していくことで、当社グループの存在意義や提供価値を経済的にも社会的にもバランスよく、かつ多面的に拡大することを目指します。

ステークホルダーへの提供価値

ステークホルダーからさらなる信頼をかちえるよう努めます



第3期中期経営計画(MTP3)

新たなビジョン・ステートメント「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーへ」を実現し、さらに長期的な目標を達成するため、2024年度から2026年度までの新たな中期経営計画を策定しました。

▶ 「第3期中期経営計画 [MTP3、2024～2026年度]」の概要

半導体テスト関連市場は、短期的なダウンサイクルを織り込みつつも、中長期的に成長を続けると見込んでいます。MTP3期間においてもそのシクリカルグロース構造に変化はなく、目下の半導体テスト関連市場は調整局面を未だ脱しきれていないものの、2024年度から再び成長サイクルを迎えると見込んでいます。また、半導体市場の拡大に加えて半導体の複雑性への対応が業界における構造課題となる中で、当社グループの事業機会は中長期的に拡大するものと考えています。そうした環境下、当社グループは新たに策定したビジョン・ステートメントに沿い、下記の4つの戦略を推し進めることで中長期的なステークホルダーへの提供価値拡大に取り組みます。

[戦略]

1. コア市場の成長率を上回る成長実現

これまでの成長戦略に沿い、当社グループは事業領域を年々拡大してまいりました。その結果、かつては半導体テスト（ATE）市場が注力すべき市場の大半を占めていましたが、MTP3以降はATEを中核としつつも、これまで広げた領域をコア市場としながらさらなる成長に取り組みます。この拡大したコア市場においては今後、半導体の生産量増加、半導体の高性能化対応、そして半導体の複雑性進行への対応が重要な成長機会となると想定しています。これに対しては、個々のテスト・ソリューションの性能向上に加え、顧客に“Automation of Test”、すなわち半導体テストの効率性向上をもたらす新た

な価値を、当社が擁する多様な製品・ソリューション群の有機的な結合や社外パートナーとの連携などを通じて創造します。これらにより、当社の今後のコア市場において、市場成長率を上回る事業成長を引き続き実現することを目指します。

2. 近縁市場・新規事業領域への展開

半導体の高性能化や複雑性が進行する中では、より広く、統合されたテスト・ソリューションが望まれます。当社グループはこれまでもシステムレベルテストやテスト周辺機器への事業展開を進めてきましたが、今後もこのアプローチを継続することで顧客への提供価値をさらに拡大します。具体的には、当社製品のインストールベースを活用したフィールド・サービスやAdvantest Cloud Solutions™の販促に取り組むほか、Applied Research Teamによる事業機会創生にも挑戦します。

3. オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを推進

当社グループは、Chief Technology OfficerをはじめとしたCxOがグループ全体のオペレーションを管掌するCxO体制へすでに移行しています。今後、各CxOの強いオーナーシップのもと社内技術の活用を部門横断的に進めることで、半導体業界におけるテスト課題を解決していきます。また、当社グループのステークホルダーすべてにとって価値がある企業となるためには、製品や技術面の優秀さだけでなく、あらゆるオペレーションの効率性と効果性を高めていく必要があると認識しています。それに向け、DXを通じた社内オペレーションの迅速化と省人化、強靱なサプライチェーンの構築、有能人財の登用や社員教育の拡充などによる人的資本強化、AIやデータ・ア

ナリティクスを活用した社内生産性向上などに取り組みます。

4. サステナビリティの取り組み強化

当社グループにおける長期的な経営の目標は、ステークホルダーに対する提供価値をバランスよく多面的に拡大することにあります。気候変動や人権問題をはじめとするサステナビリティ課題に対する能動的かつ積極的なアクション、法令遵守や企業倫理の徹底を含めた責任ある事業活動の遂行、リスクマネジメントの強化やコーポレートガバナンスの高度化などを通じて企業価値向上基盤をさらに強化するとともに、各ステークホルダーからより厚い信頼を得られるよう努めます。これらによりサステナビリティ、すなわち現在の生活水準を維持しつつ、未来の世代が同等またはそれ以上の生活水準を享受できるようにすることに貢献します。またサステナビリティに関する取り組みの推進にあたっては、その根源となるものは企業内の共通カルチャーや価値観であることから、これらの醸成と浸透にも努めます。

▶ 経営指標

MTP3では、上記の4つの戦略を通じて収益拡大、収益性改善、資本効率向上を図ることで、企業価値の向上に取り組みます。これに沿い、MTP3において重視する経営指標を売上高、営業利益率、当期利益、投下資本利益率（ROIC）、基本的1株当たり当期利益（EPS）とし、これらの向上に努めます。なお各指標の進捗を中長期視点で評価するため、経営指標には市場変動の影響を平準化できる3力年平均の値を用います。

コスト・利益構造

優れたテスト・ソリューションの販売促進、サプライチェーン・マネジメントや製造オペレーションの最適化などを通じ、売上総利益率の改善に取り組みます。また研究開発投資や人的資本強化投資など、持続的な価値創造の源泉となる費用については積極的に投下する一方、DX化などの経営効率や業務生産性を高める施策を展開することで収益構造の継続的な改善に努めます。他方で、世界経済や当社の市場環境における将来の不確実性は高い状態にあります。環境変化に即した機動的な財務マネジメントを遂行していくことで、経営目標の達成に努めます。

資本政策、株主還元

資本政策として、研究開発、設備増強、M&A等の成長に向けた事業投資を優先します。半導体市場の長期的拡大と半導体のさらなる高性能化に即して当社グループの将来キャッシュ創出力が拡大するよう、MTP3期間中に予想される累計6,000億円以上の営業キャッシュ・フロー（研究開発費控除前）を、中核事業におけるオーガニック成長投資ないしノン・オーガニック成長投資、および近縁市場への事業展開の加速に振り向けます。また、資本効率と資本コストに配慮したバランスシート管理の見地から、負債（デット）も柔軟に活用してまいります。さらに経営基盤の強化および持続的企業価値創造のために、財

務健全性を維持した上で適正な資本構成を図る方針であります。

2024年4月から始まったMTP3の3年間における株主還元方針は、安定した事業環境を前提として、配当については1株当たり通期30円を最低限とする方針のもと、安定的・継続的な配当実施に努めてまいります。総還元性向*に関しては、MTP3期間の3年間合計で50%以上を目途とします。

また手元現金水準については、平時における目安を1,000～1,200億円と見積もっています。成長投資や運転資本への資金需要を超えて余裕資金が生じる場合は、配当や自己株式取得を通じて株主に還元します。

*総還元性向：(配当額+自己株式取得額)÷連結当期利益

	MTP2(2021～2023年度)平均実績	MTP3(2024～2026年度)平均目標*1
売上高	4,879億円	5,600 - 7,000億円
営業利益率	24.7%	22 - 28%
当期利益	933億円	930 - 1,470億円
投下資本利益率*2 (ROIC)	25.5%	18 - 28%
基本的1株当たり当期利益 (EPS)	124円	127 - 202円

*1 MTP3財務目標値の前提とした為替レートは1米ドル=140円、1ユーロ=155円
*2 投下資本利益率：NOPAT÷投下資本(期首・期末平均)。NOPAT：営業利益×(1-税負担率25%)。投下資本：借入金+社債+資本合計(リース負債含まず)

コラム：進化する半導体～複雑化する半導体試験に効率性をもたらす"Automation of Test"～

『複雑性の時代』を迎える以前の半導体業界

半導体業界に関連する最も有名な言葉の一つは、『微細化』でしょう。より微細な回路をシリコン上に形成するための技術改良が露光技術を中心に継続的かつ意欲的に行われてきました。またその結果、より小型・高性能・安価な半導体の実現と普及が進み、デジタル社会発展の礎となりました。

そして半導体の普及は、半導体を使うエレクトロニクス機器のさらなる高性能化とエレクトロニクス機器市場の成長を促し、半導体のさらなる需要拡大を促すことに繋がりました。これを受けて、技術投資だけでなく、半導体の生産量を一層引き上げるための投資も意欲的に行われ、半導体をより経済的かつ効率的に供給する体制が業界として整備されてきました。

さらなる進化が求められる半導体

しかし、半導体にさらなる性能向上を求める声は、近年ますます高まる一方です。その代表的なものは、AIの急速な社会実装を背景とした、生成AI用半導体デバイスの高性能化です。より適切な回答を導きだすAIを実現するためには、従来よりも大量のデータをさらに高速に計算・保存・通信できる、非常に高性能な半導体デバイスが必須です。さらに、単に半導体の処理能力を高めるだけでは不十分です。GHG排出量を抑制していくという社会的な要請にも半導体業界として応えていくためには、半導体が動作する際のエネルギー効率をこれまで以上に高めていく必要があります。

半導体業界の将来

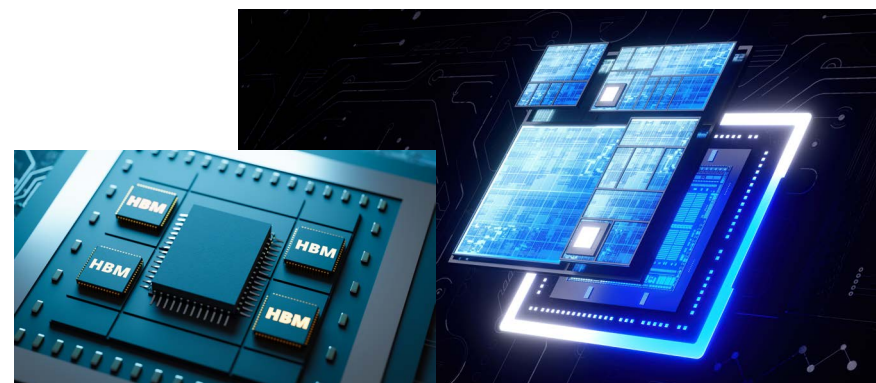
このような技術的・社会的な期待や要請を背景とし、半導体の高性能化とエネルギー消費効率の向上を両立したイノベーションをどのように実現していくかが、半導体業界の最大の課題となっています。

さらに微細な回路を形成するための技術開発に多くの努力が引き続き傾けられているほか、微細化以外の手法を通じたイノベーションとして、半導体の回路構造や素子形成技術の改良に向けた研究開発が進んでいます。これらを通じ、より多くのトランジスタを集積し、同時にエネルギー消費効率を高めた半導体デバイスが今後実現されていく見通しです。

また、微細化や回路形成技術の改善といった、半導体単体の性能向上を追求する取り組みと並行して、複数の半導体を一つのデバイスとして統合することで高性能化を実現する、いわゆる先端パッケージ技術に近年業界の注目が集まっています。中でも、異なる種類の半導体デバイスを一つの「システム」としてパッケージ化する「ヘテロジニアス・インテグレーション(異種統合デバイス)」に対する普及・実現に向けた取り組みが加速しています。

また複数の半導体デバイスを組み合わせる際に、垂直方向に半導体チップを積み上げて電氣的に接続することで配線を短くし、さらなる半導体の高性能化を実現する技術の開発も進んでいます。

これらの取り組みはいずれも画期的なものです。どれか一つだけ実現できれば良いというものではありません。今後の社会的ニーズに対し、業界として早期に伝えていくためには、上記の取り組みのいずれもが実現される必要があります。半導体業界では、それぞれの手法の最適化を追求しつつ、複数の改善手法を同時に組み合わせることで、より複雑で高性能な半導体を実現していくことを目指しています。



コラム：進化する半導体～複雑化する半導体試験に効率性をもたらす"Automation of Test"～

半導体試験の複雑化

以上のような業界を挙げた取り組みを通じ、半導体デバイス内部の回路はより大規模でかつ、より複雑なものとなる方向へ進化しています。その結果、半導体の複雑性は、過去と比べて指数関数的に増加していく見通しですが、これは半導体業界に新たな課題をもたらすことにつながります。

例えば、半導体の性能を高めるための技術の相互依存性は、業界課題に拍車をかけることの代表的な例です。半導体は、数多くの設計・製造技術をすり合わせ、また技術間のバランスを高度にとることで、正確な動作を実現しています。しかし複雑化した半導体においては、局所的な技術変更の影響度を事前に完全に予測することは不可能であり、良かれと思って部分的に導入した新技術が半導体全体の動作に思わぬ悪影響を与えてしまうような事態が容易に起こります。

そうした不具合を事前に検証し除去するためのツールとして、半導体試験に対する期待は高まる一方です。半導体の複雑化に応じて、半導体の試験もまた、これまでよりも大規模で、複雑で、そして精密

な試験が業界として求められていくこととなります。しかしこれは、多くの技術的な挑戦を必要とします。

とりわけ、異種統合デバイスの動作を確認する試験では、新たなテスト・チャレンジが起きます。例えば半導体デバイスを試験するために電流を流した時に生じた熱が、統合された他の半導体デバイスの試験に悪影響を及ぼすこともあります。この発熱への対応も含め、複雑性の時代における半導体試験は、これまでよりもより包括的で、洗練されたソリューションが求められていきます。

具体的には、複雑性を増した半導体に対して求められる試験とは、テストされる半導体がもつ複雑性を一つひとつ解きほぐし、確認していくことでもあります。すなわち、複雑化した半導体の試験プロセスにおいては、業界を横断する学際的なアプローチが必要です。

半導体テスト・ソリューションを提供する企業には、大規模な試験を正確かつ効率的に行える環境を実現することに加え、半導体の設計から量産までの各プロセスにおける課題を把握し、それらの分野に関わる企業と密接に連携していくことが求められていきます。

当社の取り組み

数あるさまざまな半導体製造装置の中で半導体テストがユニークなのは、半導体の内部に複雑に形成された回路に対し、外部から実際にアクセスしながら動作を確認することができる、という点です。試験を通じて取得したこのアクセス結果をデータ化し、それを設計工程にフィードバックすることで、回路の不具合を取り除いたり、さらなる性能改善をサポートしたりすることができます。さらには、半導体が組み込まれる最終製品の製造工程に半導体テストの検証結果をフィードバックすることで、エレクトロニクス業界全体にさらなる効率化を提供することも今後可能と考えています。

当社は、これまでに拡充してきたプロダクト・ポートフォリオをお客さまの課題・要望に応じて組み合わせ、複雑化する半導体試験にさらなる効率性をもたらします。半導体テストとインタフェース製品のコンビネーションといったハードウェア製品の組み合わせ最適化はもとより、ソフトウェアによる高速・高精度なアナリティクス技術や、当社が過去蓄積した知見を総合したテスト・コンサルテーションまでを一体的にパッケージしたソリューションを提供していきます。このように、複雑化する一方の半導体試験に対しの確かなソリューションを届けることで、当社は半導体バリューチェーンの一段の効率向上と業界発展の加速に寄与します。



“Automation of Test”で半導体産業の課題解決に貢献

CFOメッセージ



三橋 靖夫

経営執行役員
CFO (Chief Financial Officer) &
CSO (Chief Strategy Officer)

経営指標について

今回のMTP3では、5つの財務KPIを掲げています。MTP2からの変更点としては、ROEをROICに変更しました。今後のM&Aを含めた成長投資や棚卸資産の戦略的確保などに機動的に対応する中で、借入金などの負債も活用することも考慮し、収益に対して資本と借入金を合わせた投下資本を使用することが、より経営の効率性評価に適するものと考えました。

未来を見据えた開発投資による成長とキャッシュ創出

市況の変化にも影響されますが、当社の資本コストを10%程度と想定し、MTP3でのROICは3カ年平均で18%から28%としております。エクイティスプレッドがプラスであるべきであるように、ROICが資本コストを大きく上回る想定です。収益性の向上だけではなく、棚卸回転期間を主とした効率的な資産運営の改善を実現することで、ROIC実績を高めていくことを計画しています。

MTP3の業績目標値のレンジについては、以前より売上高の規模は底上げされたものの、MTP2期間の最終年度である2023年度に想定以上の落ち込みを経験したように、市況および業績にも急激なアップダウンが起こりうる業界であることを考慮しております。下限の営業利益率として示した「22%」の数値の意味は、売上高が下限の5,600億円の時に22%になるということではなく、売上高が下限レベルに落ち込んだとしても最低限このレベルの営業利益を確保するための施策を打っていく考えを意味しております。

特に、売上高の伸びとともに増加してきた販売費及び一般管理費について、業務のさらなるデジタルライゼーションなどで生産性の向上を図り、間接費についても増加を抑制していき、損益分岐点比率の改善につなげていく考えです。

MTP3発表後から特にAI関連などのSoC半導体について急激にテスト需要が高まり、2024年度が当初の想定から大幅に伸長する見込みとなりました。MTP3では2024年度がやや低調

に始まり、2025年度・2026年度に伸びていく姿を考えておりましたが、この2024年度の急峻なテスト需要の増加がMTP3期間全体を引き上げるのか、単なる前倒しによる需要なのか、現在、慎重に見定めているところです。

MTP3 経営指標

	MTP2実績 (FY21-23平均)	MTP3目標 ^{*1} (FY24-26平均)
売上高	4,879億円 ▶	5,600 - 7,000億円
営業利益率	24.7% ▶	22 - 28%
当期利益	933億円 ▶	930 - 1,470億円
投下資本利益率 ^{*2} (ROIC)	25.5% ▶	18 - 28%
基本的1株当たり 当期利益 (EPS)	124円 ▶	127 - 202円

^{*1} MTP3財務目標値の前提とした為替レートは1米ドル=140円、1ユーロ=155円

^{*2} 投下資本利益率：NOPAT÷投下資本(期首・期末平均)。NOPAT：営業利益×(1-税負担率25%)。投下資本：借入金+社債+資本合計(リース負債含まず)

CFOメッセージ

キャピタル・アロケーションについて

まず稼得する営業キャッシュ・フロー（営業CF）について、営業利益率こそMTP2と同等ですが、売上を大幅に伸ばす計画から、絶対金額ベースではMTP2から大きな伸びを見込んでいます。また、2024年度に支出する法人所得税が2023年度よりも少なくなる点、さらにMTP2期間に増加した戦略的在庫がキャッシュ化されることなども営業CFの伸びる要因として考慮しています。

今回のキャピタル・アロケーションでは、研究開発費を営業CFの見通し額から抜き出して記載しております。MTP3では「複雑性」がキーワードですが、その中に含まれる顧客の高度な半導体製造技術の進展に対し、半導体試験におけるソリューションをタイムリーに提供していくこと、つまり継続的な技術開発投資がこのビジネス機会を確実なものにしていくために非常に重要であるということを改めて強調します。

売上高も伸びる中で、売上高比での研究開発費率は低下しているように見えますが、研究開発は私たちの経営理念を支える重要な投資であります。したがって、研究開発費は2016年度から毎年増加させており、MTP2からMTP3期間でも360億円、約20%増加させる計画です。

成長投資1,600億円のうち、設備投資が600億円、M&Aを含めた戦略投資が1,000億円と考えています。設備投資がMTP2の639億円から減額する予想となっていますが、MTP2では米国での生産工場に加え、業容拡大に応じたグローバル

各拠点のオフィス拡張など一時的な投資がありました。開発・生産・販売など、ビジネス関係への投資は弱めない計画です。

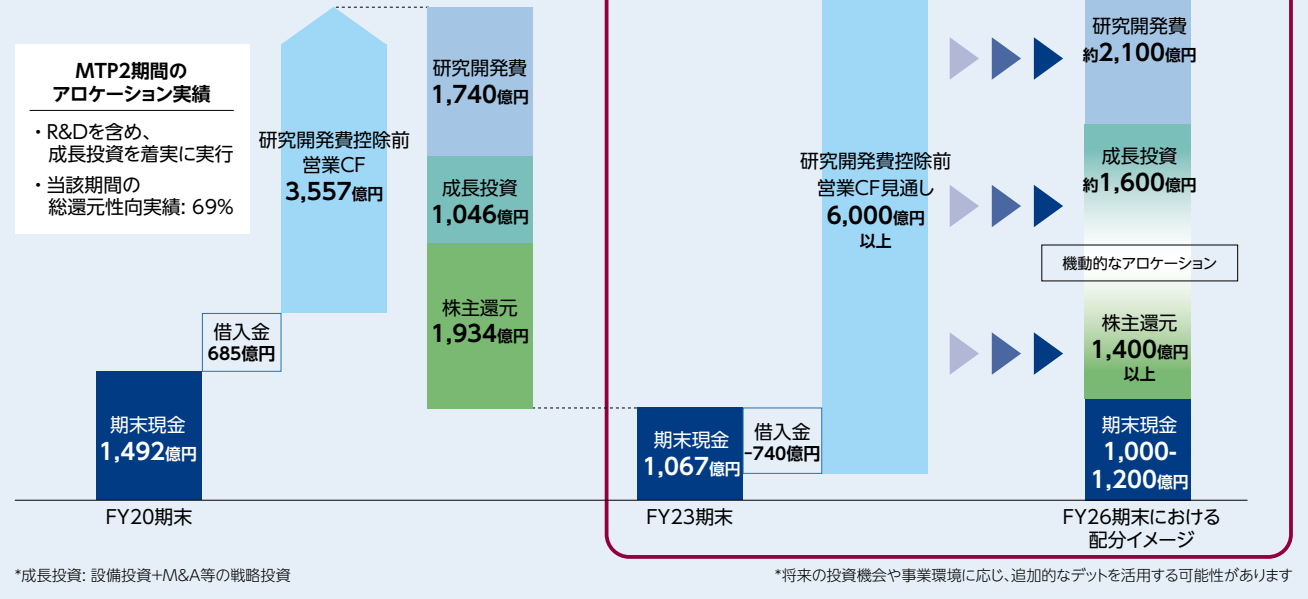
株主還元の方針は、MTP2同様に総還元性向50%以上を目指すにしていますが、あくまでも成長投資の機会を優先することになります。1株当たりの最低配当額は通期30円としています。これは2023年度実績の1株当たり34.25円から下げること考えているわけではなく、減配せずに緩やかでも増配が継続できれば良いと考えています。配当額が総還元性向50%以上に届

かない分については、自己株買いを機動的に実施していく予定です。

現預金平均保有残高について、MTP2での残高目安は1,000億円でしたが、MTP3では1,000億円から1,200億円と幅を持たせる形で少し増やすことを考えています。当社は、不透明感が高まる市場や政情不安などのビジネスリスク対応として現在600億円のコミットメントライン契約を保持しており、この契約継続についてはビジネス環境を勘案しながら検討していきます。

MTP3 キャピタル・アロケーション

事業成長投資やM&A等の戦略投資への配分を優先。
ただし今後の状況に応じ、追加的な株主還元も柔軟に検討



リスクマネジメント

当社は世界中に拠点を持ち、各拠点の機能も多様化しています。

その中で効果的にリスクマネジメントを行うため、平常時は各ユニット(各事業部や地域統括会社等)が自律的にリスクマネジメントを行い、緊急時はトップダウンでリスクに対応する体制を取っています。

基本的な考え方

当社は、データ爆発、AIを活用する新たなアプリケーションの台頭により一層促進されるデジタル革命、社会情勢の変化の加速など、事業環境が大きく変わろうとする中でも、ビジネスチャンスを実確にとらえ、挑戦をしていくために、現在および将来に存在するリスクを特定し、備え、適切な対応をすることが必要不可欠であると考えています。そこで、当社では、経営戦略とリスクマネジメントを結び付ける方法でリスクを抽出し、現在だけでなく将来に存在するリスクも網羅的に特定することとしています。各ユニットにおいて、経営戦略などの達成を阻害する要因としてのリスクを俯瞰的に特定し、リスクの重要度に応じて適切なリスク対応を取っています。

また、リスクが顕在化した場合に速やかに対応できるような体制を整えることも重要であると考えています。各ユニットは、いわゆる2線（管理部門等）、3線（内部監査部門）との連携を行い、日ごろからリスクの顕在化に備えています。

当社は、このように、各ユニットが自律的にリスクマネジメントを行い、その状況を経営陣が監督するリスクマネジメント体制を基本としています。

リスクマネジメントの体制

(1)組織

内部統制委員会が定めたリスクマネジメント方針の下、各ユニットがリスクマネジメントを行い、その状況を内部統制委員会が監督・評価してフィードバックを行います。

コンプライアンスに関するリスクはChief Compliance Officer (CCO) に情報が集約されます。その他、取締役会、経営会議に直接報告されるリスク情報もあります。

また、有事の際に迅速に対応するため、経営執行役員社長を本部長とする危機管理本部も設置されています。

(2)プロセス

取締役会、経営会議が策定した経営計画を、各ユニットが自部門の施策に落とし込みます。

内部統制委員会では、それらの施策達成を阻害する要因をリスクと定義し、各ユニット(各本部・事業部門・主要な海外拠点(6拠点))にリスクの特定およびリスク対応の報告を求めるとともに、全社的な視点から各ユニットのリスク分析およびユニット間の情報共有等をサポートしています。各ユニットは、自部門

におけるリスクマネジメントの状況を、年2回内部統制委員会に報告します。内部統制委員会は各ユニットのリスクマネジメント状況を確認し、各ユニットに対してフィードバックを行います。内部統制委員会事務局から、各ユニットに対し、適宜、リスク分析・対応の提案、情報提供等の支援も行っています。

また、コンプライアンスに関するリスクはCCOに情報が集約され、CCOを通じて取締役会・経営会議に定期的に報告されています。コンプライアンスに関するインシデント発生時には、CCOが迅速に関連ユニットに対応を指示し、対応状況を取締役会・経営会議に報告しています。リスクの性質に応じて、取締役会または経営会議に直接報告されるリスク情報もあります。取締役会または経営会議では、適時に意思決定をして関連ユニットに指示を出す等、コーポレートレベルでのリスク対応を行っています。

緊急の案件が生じた場合には、危機管理本部の指示のもと、より迅速な対応が可能となっています。

リスクマネジメント

主要なリスクと対応

2023年度に、各本部・事業部門・海外拠点が特定したリスクは約350件あります。そのうち、第3期中期経営計画で掲げた4つの戦略を遂行する上で注視している主なリスクは以下のとおりです。

第3期中期経営計画 4つの戦略

- ① コア市場の成長率を上回る成長実現
- ② 近縁市場・新規事業領域への展開
- ③ オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを推進
- ④ サステナビリティの取り組み強化

主要なリスク	関連する戦略	主な対応	責任者*
1 半導体産業の顕著な需要変動	①③	- 近縁市場への事業拡大 - 生産のアウトソース化、調達先の分散 - リカーリングビジネスや新規事業を含むサービス他事業の強化 - 顧客、海外拠点等とのコミュニケーションを強化、正確な情報の収集	CSO
2 開発・設計の遅延、性能未達等に起因して新製品がタイムリーにデリバリーできないことによるシェアの低下	①②③	- リーディングカスタマーとの関係強化、情報収集 - 開発開始時の十分な検討および各フェーズでのデザインレビューの実施等により無駄の少ない開発の実施 - 半導体製造工程のデータ解析を活用した新製品の研究	CTO
3 部品が調達できず製品をタイムリーに提供できないことによるシェアの低下	①③	- 代替部品の選定、標準品の使用等、特定のサプライヤーに過度に依存しない体制の構築 - サプライヤーの継続的な評価・見直し	CSCO
4 競合他社との競争、値下げ圧力による収益性の悪化	①	- 顧客ニーズの把握 - 独自の機能、付加価値の高いソリューションの提供	CCRO
5 当社やサプライヤーの主要施設が天災等により通常の操業ができなくなった場合の影響	①③④	- BCP計画の策定、情報収集 - サプライヤーのBCP対応状況の確認 - 生産拠点や外部サプライヤーの分散化	CSCO CCO
6 グローバル事業展開に伴う世界経済・政治の影響	③	- タイムリーなリスク情報の収集 - 顧客、サプライヤーとの関係強化 - 新たな出荷プロセスの確立、デュアルサプライの確立による調達ルート、生産拠点の柔軟化 - 調達基本方針の策定、サプライヤーに対する人権、労働安全への理解を求める働きかけ	CCO CSO CSCO
7 環境関連の法規制の厳格化により多額の対応費用が生じるリスク	①④	- 環境関連の法規制の動向をモニター - 代替技術の検討	CSO CTO
8 専門性の高い人材の不足	④	- 中長期的な採用計画の策定 - 働く環境の改善、エンゲージメント向上 - キーエンジニアに対するリテンション制度の導入 - 社員教育への投資、知識・技術伝承の仕組みづくり	CHO
9 法令や社会的倫理への違反、製品の信頼性や安全性の低下などによる当社への信用の毀損	④	- 社内プロセスの適切な設定と監視 - 従業員のコンプライアンス教育強化 - 製品品質の定期的なレビュー、生産過程における品質確認および品質保証部門によるクロスチェック	CCO
10 当社グループの情報技術ネットワークやシステムが被害を受けることによる当社の業務停止、信用毀損リスク	④	- サイバー攻撃の検知強化 - 定期的な情報セキュリティ教育 - 情報セキュリティインシデントに対する初動体制の構築	CCO CIO

*CCO: Chief Compliance Officer CCRO: Chief Customer Relations Officer CHO: Chief Human Capital Officer CSCO: Chief Supply Chain Officer
CSO: Chief Strategy Officer CTO: Chief Technology Officer CIO: Chief Information Technology Officer

サステナビリティの取り組み強化

アドバンテストは、企業理念体系「The Advantest Way」と中長期経営方針「グランドデザイン」に沿った経営を推進しています。「サステナビリティとは、将来のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満たすこと」と捉え、当社グループの社会的貢献拡大とステークホルダーへの提供価値のさらなる創造を図るという観点のもと、The Advantest Wayの構成要素として「サステナビリティ基本方針」を策定し、これを基盤にサステナブル経営の推進に努めています。

サステナビリティ課題に対する考え方

アドバンテストは、「先端技術を先端で支える」という経営理念のもと、常に自己研鑽を重ね、世界中のお客さまに満足していただける製品やサービスを提供しています。当社の測定技術は、エレクトロニクス技術の進化を支え、社会の発展に大きく寄与してきました。さらに、持続可能な未来社会の実現には、優れた半導体の開発・製造・普及が不可欠であり、これに貢献することが「安全・安心・心地よい」社会の構築と自社の成長に繋がると考えています。

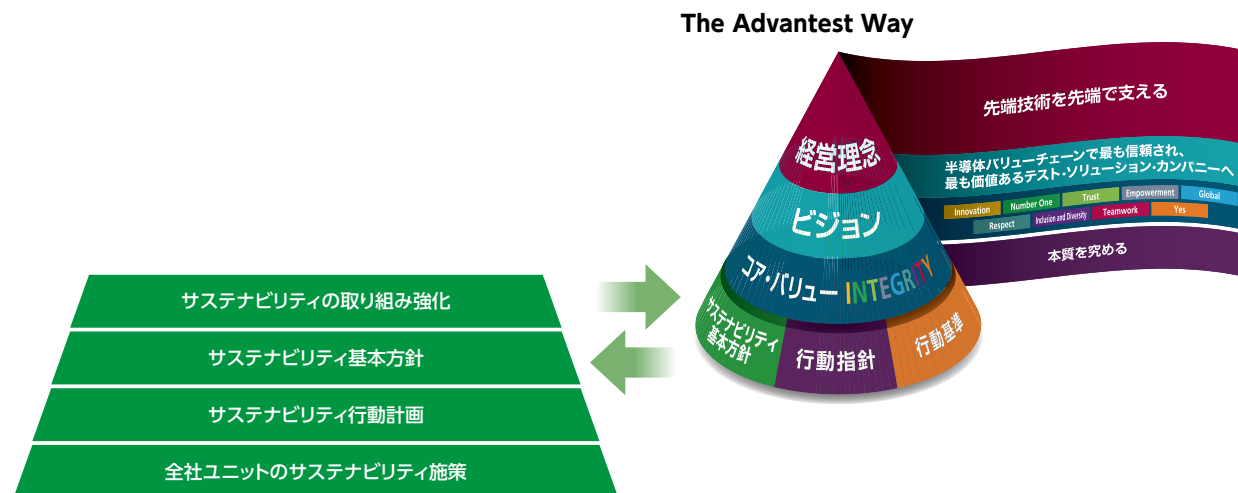
こうした考えをもとに、当社は中長期経営方針「グランドデザイン」に沿った新たなビジョン・ステートメント「半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテスト・ソリューション・カンパニーへ」を掲げ、サステナビリティ強化を重要な戦略課題と位置づけました。私たちは、ステークホルダーの期待や要請を事業活動に適切に反映し、経済的・社会的価値をバランスよく提供することを目指していきます。

また、今期は、2024年度から2026年度までの中期経営計画（MTP3）の策定に合わせて、サステナビリティ行動計画も見直しました。主要なステークホルダーを6つのカテゴリーに分け、

それぞれに提供すべき価値を定義し、新たな目標を設定しています。私たちは、ステークホルダーに価値を提供しつつ、負の影響を避け、信頼関係をより強固に築くことを目指します。

▶ P.29-30 // サステナビリティ行動計画2024-2026

同時に、持続可能な社会の実現と自社の成長を両立させるため、コーポレートガバナンスの強化にも注力し、法令遵守や企業倫理の徹底、リスクマネジメントの強化を継続的に進めていきます。



サステナビリティの取り組み強化

≫ 半導体とサステナビリティ

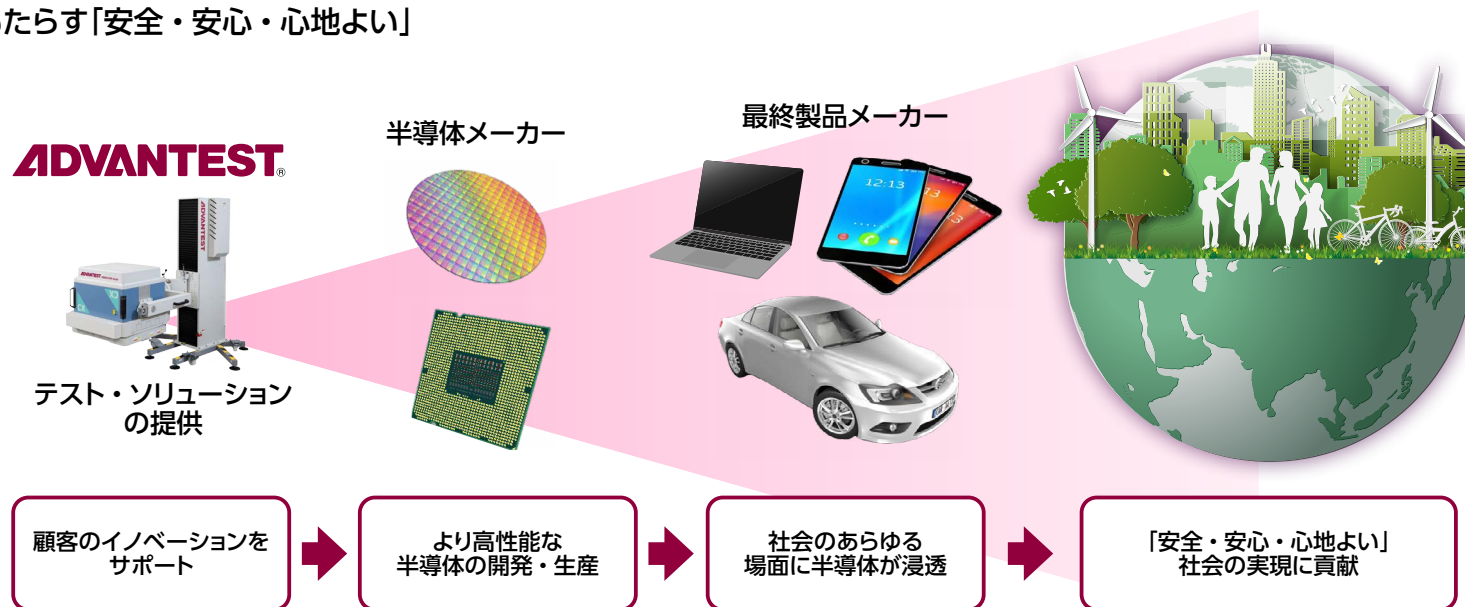
アドバンテストは、半導体がサステナブルな社会を支えると考えています。

半導体はパソコンやスマートフォンだけでなく、家電や自動車、産業機器などのキーパーツとして社会の隅々にまで浸透しています。あらゆるものがインターネットにつながり、ネットワークに接続される電子機器の増加とともに世界のデータ量も年々増加しています。

一方で、環境負荷低減への要求は半導体にも影響を与えています。半導体の小型化・高性能化と省エネルギー化が進むことで消費電力の伸びは抑制されています。また、パワー半導

体の性能向上や普及も目覚ましいものがあります。より高性能な半導体を半導体メーカーが提供できるよう、アドバンテストはテスト・ソリューションを提供する役割を担っており、それが世の中の省エネに直結する関係であります。世の中のデジタル・トランスフォーメーション（DX）とグリーン・トランスフォーメーション（GX）の2軸によって導かれる半導体の進化に対して、顧客が抱える課題（高度な品質・性能保証、最短期間での垂直量産立ち上げ）に応え続けることがアドバンテストの使命です。その使命の遂行にあたっては、すべての役員および従業員が「The Advantest Way」を理解し、あらゆるステークホルダーの尊重と持続可能な社会の実現を目指すと同時に、当社の持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に努めます。

Ⅰ 半導体テストがもたらす「安全・安心・心地よい」



サステナビリティ行動計画2024-2026

》ステークホルダーへの提供価値とインパクト創出のために

2024年度以降の当社グループのサステナビリティに関する中期的な取り組みの全体像およびそれぞれの中期目標として、「サステナビリティ行動計画2024-2026」を策定しました。

サステナビリティに関する新たな中期的な行動計画の策定にあたっては、中長期経営方針「ブランドデザイン」および第3期中期経営計画(MTP3)と連動した取り組みとなるよう、取り組むべきテーマをステークホルダーへの提供価値拡大という観点に基づくものへ全面的に再編するとともに、それら各テーマに対する中期目標を新たに設定しました。

サステナビリティ行動計画2024-2026

ステークホルダー	重点テーマ	目標	担当役員 (注1)	KPI	目標値(2026年度)
株主・資本市場	中長期かつ持続的な企業価値向上	さらなる収益の拡大、収益性の向上、資本の効率的活用への追求	CFO	MTP3経営指標に準じる	MTP3経営指標に準じる
	情報開示の強化	財務情報、非財務情報の適時適切な開示	CFO	ESG評価機関等による評価	主要な評価機関による評価の維持・向上
従業員	多様性の尊重	ジェンダー・ダイバーシティの推進	CHO	女性管理職比率(注2)	11%
			CHO	管理職候補(Level 6)における女性比率(注3)	16%
	従業員エンゲージメント	魅力ある企業文化の醸成、浸透	CHO	離職率	半導体業界平均を下回る状態を維持する
			CHO	Gallup社サーベイのスコア(注4)	3.8
			CHO	The INTEGRITY Awardノミネーション件数/年(注5)	400件
	人財への投資	健康経営、ウェルビーイング経営、ワークライフ・バランスの推進	CHO	日本:ホワイト500認定 グローバル:2024年度中に決定(注6)	日本:ホワイト500認定
		Advantest Development Frameworkに基づく育成推進	CHO	教育・研修費用	8億円
顧客	卓越したソリューションの提供	顧客課題を解決する新製品や統合ソリューションの提供	CTO	マーケット・ポジション	注力市場における業界No.1の維持
	顧客満足度向上と顧客との信頼関係強化	高付加価値かつ包括的なサポートを迅速かつ正確に提供	CCRO	マーケット・ポジション	注力市場における業界No.1の維持
	気候変動対策・環境負荷軽減	製品の環境性能向上	CTO	電力最適化製品の開発	2024年度中に決定
			CCRO	環境性能に優れた製品の販売促進	2024年度中に決定
			CSO	製品ライフサイクルアセスメントの強化	管理範囲の拡大とデータ精緻化

サステナビリティ行動計画2024-2026

ステークホルダー	重点テーマ	目標	担当役員 (注1)	KPI	目標値(2026年度)
サプライヤー	サプライチェーンにおける人権の尊重、公正な取引	責任ある鉱物調達	CSCO	紛争鉱物調査に関する取引先からの回答の回収	99%
		サプライチェーンにおけるサステナビリティの浸透	CSCO	指定取引先に対するデュー・ディリジェンスの実施率(注7)	100%
			CSCO	指定取引先の社数(注7)	50社(指定取引先2023年度実績42社)(注7)
	GHG排出削減(Scope 3)	サプライチェーンの脱炭素化	CSCO	主要取引先に占める再生可能エネルギー導入率(注8)	60%
パートナー	イノベーションの創造、ローカルコミュニティ・グローバル社会への貢献	イノベーションやソーシャルグッドに関わる活動の実施	CSO	戦略的パートナーシップの件数	2023年度時点の水準を維持
			CCO	従業員が行った地域貢献活動の件数(業務内外問わず)	180件(2024年度～2026年度累計)
地球環境	GHG排出削減(Scope 1+2)	Scope 1+2におけるGHG排出量削減	CSO	GHG排出量削減率	65%(2018年度比)
		再生可能エネルギーの導入	CSO	再生可能エネルギー導入率	80%
		主要製品の工期短縮を通じたエネルギー使用量削減	CSCO	生産プロセスの見直しによる生産工期削減率	20%減(2020年度比)
	サーキュラーエコノミーへの貢献	3Rの推進によるリサイクル率の向上 3R:Reduce/Reuse/Recycle	CSO	廃棄物リサイクル率(日本・海外)	日本: 90%以上 海外: 73%以上
		全社の水使用量を2016年度の水準に維持する	CSO	水資源使用量	288,000m ³ /年 以下
	生物多様性や自然資本の保全	生物多様性の保全、自然保護活動の推進(ビोटープでの絶滅危惧種の保護、植林、ビーチクリーン等)	CSO	自然資本に関する社会貢献活動の参加人数	延べ600名 (2024年度～2026年度累計)
	重点テーマ	目標	担当役員 (注1)	KPI	目標値(2026年度)
ガバナンス	責任ある事業活動の徹底	国際/業界基準への対応	CSO	ビジネス行動規範およびマネジメントシステム規格への準拠	認証取得済ISOの維持・更新、RBA監査合格
		GCEP(全従業員を対象としたe-learning)の実施	CCO	e-learningによる受講率	100%
		公正かつ透明性の高い職場の実現	CCO	第三者機関による内部通報制度の認証取得を目指す	第三者機関による認証取得
		労働安全衛生の維持・向上	CHO	重大な(休職に至る)労働災害発生率(LTIR:Lost Time Incident Rate)	0%
		サステナビリティに関する社内理解の醸成	CSO	レイヤー別のサステナビリティ理解促進施策実施	施策の実施
	コーポレートガバナンスの高度化	実効性強化に向けた取締役会機構・統治の高度化	COO	取締役会の実効性確保	実効性評価結果の開示の充実
			COO	経営戦略、事業環境に即し必要となるスキルセットと多様性を充足する取締役会構成	取締役会における定期的な確認および必要に応じた見直し
	リスクマネジメントの強化	内部統制の徹底	CCO	年2回のリスクレビューに基づくリスクの明確化と改善	年2回のリスクレビューの実施

(注1) 役員一覧はP.54に記載しています。
(注2) 女性管理職比率および労働者の男女の賃金の差異は、2024年3月期有価証券報告書「第1 企業の概況 5. 従業員の状況」に記載しています。
(注3) 当社グループの資格制度はグローバル共通で10段階で、Level 6は一般社員層の最上位の資格です。
(注4) グループ全体でのサーベイは3年に1回実施しています。
(注5) INTEGRITYを体現している従業員を他の従業員の推薦により称える表彰制度です。
(注6) ホワイト500が日本における認定制度であるため当社および国内子会社が認定の対象となっています。
(注7) 取引金額ベースで上位85%を占めるTier1サプライヤーおよびそれらの主要サプライヤーであるTier2サプライヤーに対してデュー・ディリジェンスを実施します。これらのサプライヤーを指定取引先として定めています。
(注8) 取引金額ベースで上位85%を占めるTier1サプライヤーを主要取引先と定めています。

サステナビリティ行動計画2024-2026

サステナビリティマネジメント

当社グループは、「サステナビリティ基本方針」に基づき、Group CEOを含めた各CxOを個々の課題ごとの責任者に設定しながら全体の活動を推進しています。さらに、「サステナビリティ行動計画」を各ユニット単位で毎年具体的な事業計画に落とし込むことで、全体の取り組みを着実に進捗させるよう努めています。

また、サステナビリティに関する取り組みをグループ全体で機動的に推進していくために、当社グループは、経営会議直結の組織である「サステナブル経営推進ワーキンググループ

(SMWG)」を2020年度より設置しています。この組織は、すべてのビジネス・ユニット、ファンクショナル・ユニット、リージョナル・ユニットのリーダーで構成される全社委員会であり、その統括リーダーはGroup CEOが務めています。この委員会において、各ユニットにおけるESG課題の重要性分析等をもとに、全社横断的に対処すべきサステナビリティ課題についてのアップデートや議論を定期的に行うことで、サステナブル経営のさらなる推進と深化を図っています。

当社グループにおけるサステナビリティに関する取り組みは、案件の重要性に応じて個別に取締役会への報告や監督を受けするなど、取締役会関与のもとで推進されています。2024年度からスタートする第3期中期経営計画(MTP3)と同期して策定さ

れた「サステナビリティ行動計画2024-2026」においても、その内容および目標に対し、経営会議で審議・決定の上、取締役会に報告されました。

これに加え、サステナビリティに関する取り組みに対する経営レベルでの責任を明確にするため、第2期中期経営計画(MTP2)期間においては執行役員に対する業績連動型株式報酬の評価指標の一つとして、サステナビリティに関する外部の評価指標を採用しました。

サステナビリティ推進体制

